

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：万联证券

金名信息技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月25日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长林宜生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司包头分行借款不超过人民币147.00万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司包头分行借款不超过人民币壹佰肆拾

柒万元（¥1,470,000.00元），期限12个月，授信用途用于公司日常经营周转；公司董事班晓峰及其配偶为此笔贷款提供连带担保责任，具体详见公司于2023年8月03日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金名信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月3日